

NEW



ADVANCED DIRECT IMAGING by ALTIX

新一代 ADIX SA neo 直接成像设备

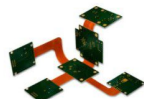
印刷电路板



柔性电路板



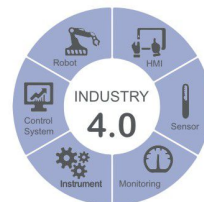
软硬结合板



金属蚀刻



产速更快
更智能



提供客制化快速&智能的影像解决方案

高解析度



30 μ m | 1.2mils

高对位精度



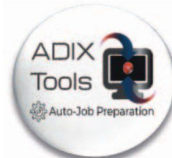
$\pm 8\mu$ m | ± 0.3 mils
影像对基板

高产能



≥ 6600 面/天

智能化数据传输



快速切换料号
&补偿设定



ALTIX
Direct Imaging & Contact Printers





- 每个成像头都有4波长的UV-LED光源 | 高解析度DMD
- 全新设计的曝光技术大幅缩短曝光时间
- 更高的UV光源曝光功率与景深
- 直观和人性化的人机界面
- 低运行成本

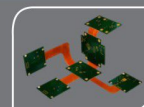
产速更快更智能

1到7个成像头 - 可提供现场扩充/升级

ADIX SA neo 设备规格

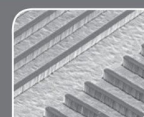
应用范围

印刷电路板, 柔性电路板, 金属蚀刻, IC载板, 触控面板
228 x 254 mm 到 610 x 762 mm | 9" x 10" 到 24" x 30"



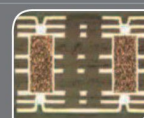
解析度

高解析度: 30μm | 1.2mils
防焊开窗: 最小 75 μm
阻焊桥: 最小可达50 μm



对位精度

±8μm | ±0.3mils (影像对基板对位精度)
±12μm | ±0.5mils (层间对位精度)



产能

以5个成像头为例, 产能可达120面/小时 (能量需求设定为30mJ/cm², 基板尺寸457 x 610mm | 18" x 24")
极短的数据预处理时间, 每个成像头均具有4波长高功率的UV-LED光源

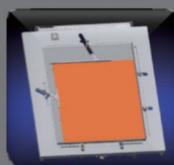


智能功能

ADIX Tools: 远程设置作业参数, 参数设定统一管理以减少人为失误
智能自动化: 智能投收板自动化, 多料号管理。可全自动, 半自动切换, 操作便捷。
新一代的影像识别演算法: 更容易抓取各类型靶标, 靶标外形因制程因素导致轮廓缺损也能侦测靶标。



独特功能



特殊设计的夹板机构

使用ALTIX专利自动夹板系统, 配合抽真空台面, 可克服不同基板(板厚、材料等)在生产过程中形成的板弯及板翘



最佳成像品质

拥有动态自动对焦(±8mm) 与大范围景深(±200μm), 以克服不平整表面造成的成像失焦, 达到最佳成像效果